

行業回顧

印刷線路板(包括柔性印刷線路板(「FPC」)及硬性印刷線路板(「PCB」))為流動電話、數碼相機、電腦產品及消費電子產品等大多數電子產品常見的基本零件之一。為了縮小體積及容納更多電子裝置零件，FPC及PCB須有更幼細的線路及更多層數。此行業於二零零五年持續增長，但競爭亦更形激烈，而競爭對手亦已擴大其產能。越來越多的FPC及PCB設施現正在中國設立，而中國的FPC及PCB解決方案供應商在全球將變得更具競爭力。

業務回顧

本集團主要從事提供FPC及PCB解決方案。於二零零五年，本集團的FPC解決方案主要針對中端市場，而其PCB解決方案則歸類為低端產品。儘管本公司自一名主要客戶及若干其他客戶接獲的新訂單有所延誤，但本集團營業額仍有所增加，主要由於與若干新客戶的業務往來及自現有客戶接獲的訂單增加。此外，本集團已改善其生產技術，例如生產供液晶體顯示器及相機組件使用的FPC及高密度連接(「HDI」)PCB的能力。預期較高增值產品將於短期內為本集團營業額作出重大貢獻。

客戶網擴大

於二零零五年，本集團不但不斷維持其現有客戶網，並已擴大其客戶網。本集團同時全面滲透若干主要手機客戶的若干主要目標客戶，包括於二零零五年取得某著名韓國客戶的正式供應商地位。董事預計，來自新客戶的貢獻於來年將佔更巨大的比重，而本集團依賴其主要客戶的程度於未來亦會減少。

改進不同產品的生產技術

1) 高速自動化FPC生產線

本集團已改進適用於中空FPC的生產技術。產能標準已提升至生產細線FPC。為進一步加強本集團的生產設施，本集團將於來年購置Roll to Roll機械。透過這些機械，生產FPC的各個生產工序將可實現自動化，從而提升品質及產量。本集團預期FPC的細線及間距的市場需求於未來數年將會增加。

2) HDI PCB

HDI PCB產品在PCB市場極具發展潛力。本集團於二零零五年試產HDI PCB，並已成功掌握穩定生產HDI產品所需的技術知識。為應付大規模生產及較多層數HDI PCB的要求，本集團計劃購置更多高速及自動化的設備，例如激光鑽機及濕製程設備。

3) 表面裝配技術 (「SMT」) 解決方案

本集團於二零零五年已擴充其表面裝配技術生產設施。過去，本集團的組裝產品主要為柔性印刷線路板組裝服務 (「FPCA」) 及硬性印刷線路板組裝服務 (「PCBA」)。由二零零五年第三季開始，本集團已開始組裝電子產品成品，例如流動電話及數碼相機。

產能增長及高使用率

本集團於二零零五年下半年將表面裝配機械線由45組增加至59組。除表面裝配技術外，自上市日以來本集團FPC及PCB的產能維持於相同水平。本集團的FPC生產線尚未達其最高產能，而本集團的PCB及SMT平均產能於二零零五年已幾乎達最高產能。

財務回顧

截至二零零五年十二月三十一日止財政年度，本集團錄得營業額約176,900,000美元及年內溢利約14,200,000美元，而截至二零零四年十二月三十一日止年度則錄得營業額約165,700,000美元及溢利約25,100,000美元，分別增加約6.7%及下跌約43.5%。每股盈利約為1.3美仙 (二零零四年：約2.5美仙)，本公司每股資產淨值約為8.4美仙 (二零零四年：約5.8美仙)。

營業額

本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度的營業額及二零零四年可比較數字，按主要產品分類載列如下：

按業務劃分的營業額

	二零零五年		二零零四年		變動
	千美元	%	千美元	%	%
FPC解決方案					
FPCA	99,081	56.0	118,272	71.4	(16.2)
FPC	17,054	9.6	10,341	6.2	64.9
FPC解決方案總計	116,135	65.6	128,613	77.6	(9.7)
PCB解決方案					
PCBA	10,243	5.8	2,878	1.7	256.0
PCB	50,522	28.6	34,241	20.7	47.5
PCB解決方案總計	60,765	34.4	37,119	22.4	63.7
總計	176,900	100.0	165,732	100.0	6.7

管理層討論及分析

本集團的營業額主要來自銷售FPCA及PCB。就上表而言，截至二零零五年十二月三十一日止年度來自銷售FPCA及PCB的營業額分別約為99,100,000美元及50,500,000美元(二零零四年：118,300,000美元及34,200,000美元)，分別約佔本集團銷售總額約56.0%及約28.6%(二零零四年：71.4%及20.7%)。

二零零五年FPCA的銷售額減少16.2%，主要由於若干主要客戶延遲推出新產品，以及推出的新產品數量因市場因素及主要零件供應短缺而低於預期，反映本集團有關向若干主要客戶銷售的營業額的敏感性。董事相信，增加客戶數目可減輕本集團此方面的風險。於二零零六年首季，本集團已陸續接獲延遲發出的新產品訂單。

另一方面，PCB及PCBA於二零零五年的銷售分別增加約47.5%及256.0%，主要由於PCB解決方案的市場需求增加及新產品單位價格上升。市場需求增加反映若干現有客戶對產品的需求增加，例如對有線調解器的需求增加。

按業務劃分的毛利

	二零零五年 %	二零零四年 %
FPC解決方案		
FPCA	22.9	31.3
FPC	8.8	10.7
PCB解決方案		
PCBA	8.8	8.1
PCB	4.6	2.6
總計	15.5	23.7

本集團的毛利由截至二零零四年十二月三十一日止年度約39,300,000美元下跌至截至二零零五年十二月三十一日止年度約27,500,000美元。毛利下跌主要由於邊際利潤較高的FPC解決方案在銷售方面出現無法預計的延誤。生產設備的使用率低於預期導致平均單位成本增加。

PCBA及PCB的毛利率均有所增加，主要由於市場對較高毛利產品的需求增加以及年內推出單位價格及毛利較高的新產品以改善本集團產品組合。

營運開支

由於本集團於年內的銷售額只有輕微增加，本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度的分銷成本減少約15.7%至約3,400,000美元，而截至二零零四年十二月三十一日止年度則約為4,100,000美元。分銷成本減少，主要由於更有效地將銷售人員整合及營銷管理有所改善。此外，年內本集團減少支付的銷售佣金減少。由分銷成本組成的其他項目則與營業額水平一致。

截至二零零五年十二月三十一日止年度的行政開支增加約54.7%至約7,100,000美元，而截至二零零四年十二月三十一日止年度則約為4,600,000美元。行政開支大幅增加的主要因為年內須承擔上市費用及員工成本增加。

流動資金及財務資源

於二零零五年十月十日，本公司透過按每股1.02港元的發行價配售218,750,000股新股份及公開發售31,250,000股新股份，成功將其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。所得款項淨額約為30,600,000美元。

於二零零五年十二月三十一日，本集團的股東資金約為104,700,000美元，而於二零零四年十二月三十一日則約為57,600,000美元。股東資金增加，主要由於年內錄得溢利及透過上市發行新股份。流動資產約為180,400,000美元，主要包括銀行結餘及現金約46,300,000美元、抵押銀行存款約28,600,000美元、存貨約32,700,000美元及應收貿易款項約67,500,000美元。流動負債約為139,300,000美元，主要包括銀行貸款約83,600,000美元及應付貿易款項約41,700,000美元。非流動負債只包括長期銀行貸款約4,900,000美元。

年內，本集團的現金及銀行結餘增加，部份原因乃來自就上市發行新股的所得款項淨額，誠如本公司於二零零五年九月二十八日刊發的招股章程（「招股章程」）所披露，該等資金已確定用於為本集團的蘇州廠房購買機械及設備及興建華北廠房。本集團已增加借貸總額39,700,000美元用作擴充業務以及用於本集團的產能投資（誠如本年報中「重大投資或資本資產的前景及未來計劃」一節所述）。

於二零零五年十二月三十一日，本集團的流動比率為1.30（二零零四年：1.00），而資產負債比率（貸款總額與資產總值之比）則為35.6%（二零零四年：28.9%）。

匯兌風險

本集團的買賣主要以美元及人民幣為單位，於截至二零零五年十二月三十一日止年度美元及人民幣佔銷售比例分別約為68%及32%（二零零四年：65%及35%）。截至二零零五年十二月三十一日止年度，美元及人民幣佔採購額比例分別約為59%及41%（二零零四年：61%及39%）。以美元進行買賣大幅降低匯兌風險，本集團於截至二零零五年十二月三十一日止兩個年度均未有作出任何安排對沖其外匯風險。

分部資料

於二零零五年十二月三十一日，本集團的詳盡分部資料載於財務報表附註7。

僱員福利

截至二零零五年十二月三十一日止年度，僱員的平均數目約為5,700人(二零零四年：約5,000人)。截至二零零五年十二月三十一日止年度，本集團的員工成本(不包括董事酬金及薪酬)約為18,700,000美元(二零零四年：14,000,000美元)。本公司的薪酬政策每年進行檢討，並符合現行市場慣例。於回顧年內，本公司並未根據本公司於二零零五年七月五日採納的購股權計劃向其僱員或董事授出任何購股權。

本公司中國附屬公司的僱員為由中國地方政府設立的國家管理社會福利計劃的成員。根據有關計劃，本集團根據有關中國法規向其中國僱員提供退休、醫療、工傷、失業及懷孕福利。本集團須將彼等薪金的指定比例撥入社會福利計劃，以為有關福利提供資金。本集團就有關社會福利計劃所負的責任僅限於作出指定供款。於回顧年度內，本集團向計劃作出約1,900,000美元(二零零四年：900,000美元)的供款。

重大收購及出售與未來重大投資計劃

截至二零零五年十二月三十一日止年度，本集團並無收購及出售附屬公司及聯營公司的重大交易，惟招股章程所詳述於本公司股份在聯交所上市前進行的公司重組除外。

資產押記

於二零零五年十二月三十一日，本集團為擔保銀行借貸而質押其物業、應收貿易款項、銀行存款及預付租賃付款分別約為31,700,000美元、7,200,000美元、28,600,000美元及300,000美元(二零零四年：32,600,000美元、6,100,000美元、8,200,000美元及零美元)。

關連交易

年內，本集團有下列關連及持續關連交易：

徐中先生向本集團出租住宅大樓

本公司間接全資附屬公司佳通科技(蘇州)有限公司(「佳通科技(蘇州)」)於二零零四年九月十三日與執行董事徐中先生訂立兩份租約，據此，徐中先生向佳通科技(蘇州)出租位於蘇州的兩幢住宅大樓。這些住宅大樓現用作本集團在蘇州的員工宿舍。年內，為租用此兩幢住宅大樓而向徐中先生支付的租金總額約為18,089美元(二零零四年：15,622美元)。

向Beshine Technologies Inc. (「Beshine」) 採購物料

截至二零零五年十二月三十一日止年度，本集團向Burda Enterprise Inc.的全資附屬公司Beshine採購原料的金額約600,000美元(二零零四年：11,000,000美元)，而Burda Enterprise Inc.為董事林正弘及其聯繫人控制的公司。誠如招股章程所披露，與Beshine進行的該等交易已自二零零五年四月起終止。

除上述者外，於回顧年度並無進行其他持續關連交易。

獨立非執行董事確認該等交易已由本集團於其日常業務過程中以正常商業條款訂立，並已遵守監管該等交易的協議條款，屬公平合理並符合本公司整體股東利益。

或然負債

於二零零五年十二月三十一日，本集團或本公司並無任何重大或然負債(二零零四年：無)。

重大投資或資本資產的前景及未來計劃

1. 物色潛力客戶及業務多元化

在以後年度本集團營業目標在於有效降低對單一客戶的倚賴。本公司已有多家大型國際客戶，並於二零零六年繼續物色具潛力的新客戶。董事預期未來這些新開發客戶將為本集團帶來大量發展商機，董事相信，本集團的優質產品及效率卓著的生產能力將為本集團提供平台建立更廣泛的客戶基礎及擴大生產規模。

2. 新技術引進、新設備增添及產能的提升

為提供更優質的產品，及有效的提升生產能力及品質，擴大生產規模，本集團將增加FPC解決方案新設備用以生產供液晶體顯示器及相機組件使用的小型線路板產品，目前本集團所生產的FPC產品主要應用在彎折板、按鍵板及側鍵板等手機零件方面。預期引入這些產品擴大本集團的產品種類後，可提升本集團在爭取訂單方面的競爭力。

董事預期更先進及更富時代感的手機將使用越來越多的HDI PCB及軟硬結合板，而本集團的主要客戶對這些產品的需求亦會增加。因此，為滿足預計的需求及提供更多增值服務予客戶，本集團將增加HDI及軟硬結合板生產技術及設備的採購。

為擴充從零件或組裝代工的一站式服務以爭取現有客戶更多生意及獲取新客戶，本集團計劃擴大生產規模及業務範圍，到電子元件模組組裝或支援生產最後成品。

為實行上述策略，本集團已於二零零五年年底成立蘇州佳茂科技有限公司及於二零零六年年初成立佳永電子(蘇州)有限公司，以生產及組裝高質FPC與HDI PCB及軟硬結合板。

3. 華北投資計劃

為華北及韓國的客戶提供更佳服務。先前本集團已決定在華北興建一所工廠。本集團先前已確定一塊合適土地，並一直在評估相關工資成本及氣候(會否影響運輸及營運成本)等營運考慮因素。相關的評估顯示勞工及運輸成本較預期為高。因此，此計劃已延後將再作進一步評估。另一方面，本集團主要競爭對手於蘇州增加產能。因此，本集團現正考慮是否將華北所規劃資金先行用於蘇州擴建，以加強其競爭力以挽留現有客戶及獲取新客戶。此方面有所決定後會即時刊發相關公佈。